

國立勤益科技大學第九任校長候選人資料表

壹、個人基本資料

姓名	蔡明義	性別	男	出生年月日	57年 月 日	
國籍	<input checked="" type="checkbox"/> 本國籍 國民身分證統一編號： <input type="checkbox"/> 外國籍 護照號碼： 國名：中華民國					
通訊資料	通訊地址： 電話： (宅) 行動電話： 傳真： 電子郵件信箱：					
教授證書 (無者免填)		字號：教字第 0 一九一二三號			起資年月 100 年 8 月	
現職	服務機關名稱		專任或兼任	現職(職級)	到職年月日	
	國立勤益科技大學		專任	教授	100年8月1日	
大學以上學歷	學校名稱		院系所名稱	論文指導者 (大學以下免填)	學位名稱	領受學位年月
	國立臺灣大學		工學院機械工程學系	廖運炫教授	博士	96年6月
	國立中興大學		工學院機械工程學系	蔡志成教授	碩士	88年6月
	國立臺灣科技大學		工學院機械工程學系	-	學士	82年6月
經歷	服務機關名稱		專任或兼任 (含兼職)	職稱(職級)	任職起迄年月	
	國立勤益科技大學		兼任	工程學院院長	108年2月~迄今	
	國立勤益科技大學		兼任	精密製造科技研究所所長	110年2月~迄今	
	國立勤益科技大學		兼任	精密製造科技研究所代理所長	109年2月~110年1月	
	國立勤益科技大學		兼任	校長特別助理	106年8月~107年7月	
	國立勤益科技大學		兼任	機械工程系主任	100年8月~106年7月	
	國立勤益科技大學		兼任	創辦人辦公室主任	99年8月~100年7月	

	國立勤益科技大學	兼任	學生事務處課外 活動指導組組長	97年8月~99年7月
	台灣磨粒加工學會	兼任	第十屆理事長	113年1月~116年1月
	台灣磨粒加工學會	兼任	第九屆副理事長	110年1月~112年12月
	台灣磨粒加工學會	兼任	第八屆理事	107年1月~109年12月
	臺中市軸承商業同業公會	兼任	第二屆技術顧問	112年5月~115年5月
	低碳產業永續發展聯盟	兼任	第一屆顧問	112年3月~115年3月
	社團法人台灣平坦化應用 技術協會	兼任	第八屆理事	112年6月~114年6月

大學校長任用資格，應同時具備教育人員任用條例第 10 條第 1 項第 1 款各目資格之一及第 2 款資格，或具同條例第 10 條之 1 之資格。

◎請勾選符合之選項，並請檢附相關證明文件：

一、符合 10 條第 1 項第 1 款各目資格之一：（第 1 目至第 3 目請擇一勾選）

第 1 目：中央研究院院士。

第 2 目：教授。

第 3 目：曾任相當教授之教學、學術研究工作。

第 3 目需符合教育人員任用條例施行細則第 13-1 條第 3 項各款條件之一，或第 4 項之條件：（勾選第三目者，務請請擇一勾選以下選項）

依專科以上學校兼任教師聘任辦法擔任兼任教授、依大學聘任專業技術人員擔任教學辦法擔任專任或兼任教授級專業技術人員、依大學研究人員聘任辦法擔任研究員。（第 3 項第 1 款）

曾任專科以上學校講座教授或榮（名）譽教授，具博士學位或其同等學歷證書後，曾從事相關之教學或研究工作 8 年以上，有創作、發明或重要專門著作，在教學、學術研究上有重要貢獻。（第 3 項第 2 款）

曾任公立學術研究機構研究人員或研究技術人員、財團法人或行政法人研究組織研究人員或公民營事業機構研發部門研發人員，具博士學位或其同等學歷證書後，曾從事相關之教學或研究工作 8 年以上，有創作、發明或重要專門著作，在教學、學術研究上有重要貢獻。（第 3 項第 3 款）

本細則中華民國一百零八年八月一日修正施行前，已依本條例第十條所定曾任相當教授之教學、學術研究工作資格擔任大學校長者，具有大學校長之聘任資格。（第 4 項）

二、符合第 10 條第 1 項第 2 款資格：

大學校長應曾任學校、政府機關（構）或其他公民營事業機構之主管職務合計 3 年以上

教育人員任用條例施行細則第 13 條，所稱曾任學校、政府機關（構）或其他公民營事業機構之主管職務，指符合下列條件之一：（務請勾選以下）

曾任專科以上學校組織法規所定一級單位主管以上之職務。

曾任中央研究院組織法規所定一級單位主管以上之職務。

曾任政府機關（構）或公營事業機構薦任第九職等或相當薦任第九職等以上之主管職務。

曾任下列民營事業機構主管職務之一：

（一）在主管機關登記有案，其實收資本額在新臺幣八千萬元以上，並依其組織架構所列一級單位主管以上之職務。

（二）在主管機關登記有案，且符合衛生主管機關所定綜合醫院設置標準之醫院，並依其組織架構所列一級單位主管以上之職務。

三、教育人員任用條例民國 100 年 11 月 15 日修正之條文施行前曾任或現任同級學校校長，或符合修正前大學校長聘任資格者。（教育人員任用條例第 10 條之 1）

具備之資格條件

注意事項：

一、請檢附下列證明文件：（如為外國文件，請附中譯本並公證）

（一）最高學歷學位證書影本（國外學歷學位證書應經駐外單位驗證）。

（二）中央研究院院士或教授或曾任相當教授之教學、學術研究工作證明或擔任同級學校校長證明影本。

（三）曾任主管職務及各項經歷證明文件影本。

- 二、以上各項資格與年資之計算，採認核計至本案收件截止日（113年6月11日）為止。
- 三、候選人務必就表內「具備之資格條件」勾選，遴委會將依據候選人勾選項目進行資格審查。
- 四、【兼職】本案收件截止日前3年內（即110年6月12日以後）如有下列兼職，請務必填列：(1)營利事業機構職務。(2)財團法人董、監事或其他執行業務之重要職務。(3)其他重要職務。
- 五、本表若不敷使用，請以A4紙張自行延伸。本表資料除紙本1份外，並請繳交PDF檔。

貳、著作（含學位論文）、作品及發明目錄

學位論文

1. CMP 鑽石修整器修整聚胺酯拋光墊表面特性之研究，臺灣大學機械工程學研究所，博士論文，2007 年。
2. 晶片化學機械平坦化之機械磨耗機制研究與實驗探討，中興大學機械工程學系，碩士論文，1999 年。

期刊(近五年)

1. Y. T. Lin, K. J. Chen, C. Y. Chen, Y. X. Lin and **M. Y. Tsai***, The Study of the Performance of the Diamond Wheel's Steel and CFRP Hubs in Tungsten Carbide (WC) Grinding, Applied Science (SCI), 13(22), 2023/11. Corresponding author: **M. Y. Tsai**
2. Y. Y. Hsieh, **M. Y. Tsai***, Z. Z. Xu, Rotary Engine Rotor Side Seals Using New Machining Processes, Journal of Manufacturing Science and Engineering (SCI), 144(7), 2022/7. Corresponding author: **M. Y. Tsai**
3. K.Y. Li, Y. F. Lin, **M. Y. Tsai***, I. C. Chiu, and J. Y. Chen, Monitoring of Grinding Status of Alumina Grinding Wheel Based on Short-Time Fourier Transform, Sensors and Materials (SCI), Vol.33, No.10, 3513-3528, 2021/9. Corresponding author : **M. Y. Tsai**
4. **M. Y. Tsai***, S Y Chang, Novel Abrasive Impregnated Pads and Diamond Plates for the Grinding and Polishing of Single Crystal Silicon Carbide Wafers, Applied Science (SCI), 2021/2, 11, 1783.
5. **M.Y. Tsai***, C. C. Tsai, Development Porous Structure Diamond Slurry and Graphene-TiO₂ Slurry for Polishing Single Crystal Silicon Carbide, International Journal Advanced Manufacture Technology (SCI), 105(1-4) 1519–1530, 2019
6. **Ming-Yi Tsai***, Y.F. Lin, J. K. Ho, and J. G. Yang, Ultrasonic-Assisted Innovative Polyurethane Tool to Polish Mold Steel, Int. J.of Automation Technology (SCI), 13(2), 199-206, 2019.
7. **M.Y. Tsai***, Study on the Innovative Ceramic Abrasive Plate for Grinding Brittle Materials, International Conference on Smart Science, Gunma Japan, Mar.30-Apr.2 2019.
8. **M.Y. Tsai***, C. T. Hoo, A Novel Diamond Slurry with Aid of UV-light for Polishing Silicon Carbide, International Conference on Mechatronic, Automobile, and Environmental Engineering, Japan, 2019.
9. **M. Y. Tsai***, Yue-Feng Lin, Guan-Fu Lin, “Development of Combined Diamond Impregnated Lapping Plates”, Sensors and Materials, Vol. 30. No. 11(2) 2018/8. (SCI)
10. **M. Y. Tsai***, J. K. Ho and J. G. Yang, “An innovative Polyurethane Tool with Ultrasonic-Assisted to Polish Mold Steel” International Journal of Automation Technology, (EI) 2018/7
11. **M. Y. Tsai***, C.S. Fang and M. H. Yen, “An investigation of Vibration Assisted Deep groove EDM of Titanium alloy (Ti-6Al-4V)”, The International Journal of Advanced Manufacturing, 2018/97:297–304. (SCI)
12. Xu Zhi-Zhe, **Tsai Ming-Yi***, A Study of Gray Cast Iron Alloys Rotor Engine Air Seal Components Manufactured Processing, The International Conference on Smart Science (2018/4).
13. Hsueh-An Chen, **Ming-Yi Tsai***, Development of micro-porous ceramic grinding ingot, The International Conference on Smart Science (2018/4).

會議論文(近五年)

3. 陳奕翰、葉彥良、陳凱榮，雲端綠色科技運用於香菇生長環境監測，2024GTEA 綠色科技工程與應用研討會，2024/05。
4. 汪雨辰、蔡明義、江東源、陳凱榮，碳化矽光彈性應力檢測，2024GTEA 綠色科技工程與應用研討會，2024/05。
5. 黃豐翔、王仁智、蔡明義、陳凱榮，運用模擬分析提升除銹製程穩定性能力，

- 2024GTEA 綠色科技工程與應用研討會，2024/05。
6. 楊帛達、陳凱榮，以 Alex 卷積神經網路分辨晶圓電性檢測之缺陷分類，2024GTEA 綠色科技工程與應用研討會，2024/05。
 7. 許國壬、蔡明義、江東源、陳凱榮，使用有限元素分析複合材料雷射焊接的可行性，2024GTEA 綠色科技工程與應用研討會，2024/05。
 8. 方政翔、蔡明義、陳凱榮，運用大氣電漿噴流於晶圓表面潔淨技術，2024GTEA 綠色科技工程與應用研討會，2024/05。
 9. 詹永儒、蔡明義、潘吉祥，超音波輔助碳化矽晶圓磨削，2024GTEA 綠色科技工程與應用研討會，2024/05。
 10. 蔡明義，化合物半導體晶片材料之高速磨削與智能化技術，機械新刊，第 88 期，2024/03。
 11. Y. T. Lin, Y. X. Lin, C. Y. Chen and **M. Y. Tsai**, The study on the Grinding Performance of Poly SiC Hard and Brittle Material by Diamond Grinding Wheel, The 25th International Symposium on Advances in Abrasive Technology (ISSAT 2023/12) **榮獲最佳論文**。
 12. T. J. Tsai, M.Y. Tsai, K.J. Chen, Noisy Intelligent Grinding Process Status Monitoring, The 25th International Symposium on Advances in Abrasive Technology (ISSAT 2023/12).
 13. K. J. Hsu, Y. C. Wang, M. Y. Tsai, K. J. Chen, Feasibility Analysis of the Laser Welding Method on a Composite Vapor Chamber by Using Finite Element Analysis, The 25th International Symposium on Advances in Abrasive Technology (ISSAT 2023/12).
 14. 蔡明義，第三代化合物-半導體材料單晶碳化矽的未來，磨報 No.06，52-63, 2023/3。
 15. 蔡明義、詹永儒，創新擠膏定壓拋光模組應用於模具鋼拋光研究，中國機械工程學會第 40 屆全國學術研討會 (CSME)，2023/12。
 16. 蔡明義、沈致瑜，應用於單晶碳化矽研磨之超細目鑽石研磨盤之研究，中國機械工程學會 112 年度年會暨第 40 屆全國學術研討會 (CSME)，2023/12。
 17. 蔡明義、連宏暉，光催化複合材拋光液應用於單晶碳化矽之化學機械拋光製程研究，中國機械工程學會 112 年度年會暨第 40 屆全國學術研討會 (CSME)，2023/12。
 18. 蔡明義、沈致瑜，蜂巢式砂輪之應用，2022GTEA 綠色科技工程與應用研討會，2022/05。
 19. 蔡明義、李偉誠，超音波振動輔助鈦合金微鑽孔，2022GTEA 綠色科技工程與應用研討會，2022/05。
 20. 沈致瑜、蔡明義、江東源、陳俊延，創新蜂巢式研磨工具開發研究，中國機械工程學會第 39 屆全國學術研討會(CSME)，2022/12。
 21. 吳湧睿、許國壬、陳凱榮，兩相熱管凸面結構對於主軸冷卻流道散熱效果影響分析，中國機械工程學會第 39 屆全國學術研討會(CSME)，2022/12。
 22. 林詠潔、鄭幃任、黃守正、陳凱榮、蔡明義，CNC 工具機之柔性拋光模組應用於石墨模具之拋光研究，中國機械工程學會第 39 屆全國學術研討會(CSME)，2022/12。
 23. 趙胤璋、陳俊延、蔡明義、陳凱榮，修整砂輪標準化系統開發，中國機械工程學會第 39 屆全國學術研討會(CSME)，2022/12。
 24. 連宏暉、陳俊延、張博智、方政翔、陳凱榮、蔡明義，探討金屬改質法應用於單晶碳化矽化學機械拋光之拋光效益，中國機械工程學會第 39 屆全國學術研討會(CSME)，2022/12。
 25. 張博智、蔡榮財、連宏暉、汪雨辰、陳凱榮、蔡明義，雷射應用於軟化化合物半導體 4H-SiC 之可行性分析，中國機械工程學會第 39 屆全國學術研討會(CSME)，2022/12。
 26. 林祐祥、蔡明義、陳俊延，創新碳纖維高速鑽石砂輪磨削技術研究，中國機械工程學會第 39 屆全國學術研討會(CSME)，2022/12。
 27. 李偉誠、蔡明義、黃守正，超音波輔助切削加工鈦合金之研究，中國機械工程學會第 39 屆全國學術研討會(CSME)，2022/12。
 28. 蔡明義、李偉誠，超音波振動輔助微鑽孔於碳化矽加工之研究，2021GTEA 綠色科技

工程與應用研討會，2021/05。

29. 蔡明義、鄭幃任，拋光模組應用於硬脆材料拋光與磨棒開發之研究，2021GTEA 綠色科技工程與應用研討會，2021/05。
30. 林祐祥、蔡明義、陳俊延，高速碳纖維砂輪之應用，2021GTEA 綠色科技工程與應用研討會，2021/05。
31. 蔡明義、林佑祥，創新碳纖高速鑽石砂輪開發研究，台灣機電工程國際學會第六屆全國學術研討會論文集，2021/05。
32. 邱奕誠、林岳鋒、蔡明義、陳俊延，基於短時傅立葉轉換的氧化鋁砂輪磨削狀態監測，台灣機電工程國際學會第六屆全國學術研討會論文集，2021/05。

專利

1. 發明專利，晶錠切割裝置，I840267，2023/04。
2. 發明專利，智慧型超音波輔助研磨加工系統及其方法，I767368，2022/06。
3. 新型專利，自動對刀裝置以及磨床，M612712，2021/06。
4. 新型專利，智慧型超音波輔助研磨加工系統，M607654，2021/02。
5. 發明專利，自動擠膏定壓拋光裝置，I742924，2021/10。
6. 新型專利，紫外光裝置，D205436，2020/6。
7. 發明專利，可調式定壓彈簧刀把，I656941，2019/4。
8. 新型專利，銑削刀具，M551100，2017/11。
9. 發明專利，接觸式與非接觸式兩用之量測系統，I605530，2017/11。
10. 發明專利，嵌入式陶瓷磨削裝置及其製造方法，I602646，2017/10。
11. 發明專利，研磨拋光機，I574778，2017/3。
12. 發明專利，砂輪測試載具，I504893，2015/10。
13. 新型專利，拋光墊之拋光面結構，M506005，2015/8。
14. 新型專利，砂輪結構，M446062，2013/2。
15. 新型專利，鑽石修整器，M402167，2011/4。
16. 新型專利，超音波輔助化學機械拋光機構，M400382，2011/3。

國科會計畫(近五年)

1. 次世代智慧製造技術研究專案推動計畫－化合物半導體晶片材料之高速磨削智能化技術開發(2/4)，計畫主持人，850 萬元，2023 年。
2. 次世代智慧製造技術研究專案推動計畫－化合物半導體晶片材料之高速磨削智能化技術開發(1/4)，計畫主持人，950 萬元，2022 年。
3. 難削材加工技術與製程開發產學聯盟(三年期計畫)，計畫主持人，680 萬元，2022~2024 年。
4. 難削材加工技術產學聯盟(三年期計畫)，計畫主持人，740 萬元，2019~2021 年。
5. 科研創業計畫：綠色潔淨技術研拋單晶碳化矽創業計畫，計畫主持人，400 萬元，2024 年。
6. 第三代半導體材料-創新大尺寸單晶碳化矽製程技術開發研究(三年期計畫)，計畫主持人，274 萬元，2021~2023 年。
7. 半導體材料超音波複合加工之智慧即時監控與遠端服務技術(3/4)，共同主持人，110 萬元，2023 年。
8. 半導體材料超音波複合加工之智慧即時監控與遠端服務技術(2/4)，共同主持人，110 萬元，2022 年。
9. 半導體材料超音波複合加工之智慧即時監控與遠端服務技術(1/4)，共同主持人，80 萬元，2021 年。
10. AI 於智慧機台系統開發(四年期計畫)，共同主持人，502 萬元，2018~2021 年。

11. 創新蜂巢式研磨工具開發研究，計畫主持人，99.8 萬元，2021 年。
12. 半導體與電子產業先進材料的智慧多軸複合加工高階裝備技術(三年期計畫)，共同主持人，626 萬元，2018~2020 年。
13. 高速鑽石及 CBN 砂輪開發研究(二年期計畫)，計畫主持人，174 萬元，2019~2020 年。

政府部門計畫(近五年)

1. 教育部大學社會責任實踐計畫(USR 計畫)，計畫主持人，1360 萬元，2023-2024 年。
2. 教育部大學社會責任實踐計畫(USR 計畫)，計畫主持人，1050 萬元，2020-2022 年。
3. 財團法人金屬工業研究發展中心學界推動在地產業科技加值創新計畫，計畫主持人，697 萬元，2019~2024 年。
4. 教育部智慧機械導入與智慧製造人才培育計畫(TEEP)，計畫主持人，90 萬元，2023 年。
5. 教育部新南向及先進國家優秀外國青年學子來台蹲點(TEEP)，計畫主持人，72 萬元，2019 年。(疫情因素延至 112 年執行)

產學合作(近五年)

1. 應用半導體用晶圓於研磨加工之鑽石砂輪盤開發研究，台灣鑽石工具股份有限公司，30 萬，2024 年。
2. 12 吋超細目鑽石研磨盤加工製程開發研究，中國砂輪企業股份有限公司，30 萬，2024 年。
3. 化合物半導體材料加工製程技術開發研究，台灣應用晶體股份有限公司，100 萬，2024 年。
4. 智能化平面研磨加工製程狀態監控系統，福裕事業股份有限公司，150 萬，2024 年。
5. 研磨主軸砂輪磨耗分析，工業技術研究院，50 萬，2024 年。
6. 鑽石研磨工具開發研究，台灣鑽石工具股份有限公司，30 萬，2023 年。
7. 超細目鑽石研磨盤加工製程開發研究，中國砂輪企業股份有限公司，30 萬，2023 年。
8. 化合物半導體材料磨削及拋光加工製程技術開發，全鑫精密工業股份有限公司，150 萬，2023 年。
9. 磨粒流研磨拋光製程技術開發，健陞機電工業股份有限公司，30 萬元，2023 年。
10. 化合物半導體材料研磨工具開發研究，北聯研磨科技股份有限公司，50 萬元，2023 年。
11. 化合物半導體材料加工製程開發研究，穩晟材料科技股份有限公司，70 萬元，2023 年。
12. 研磨加工製程狀態監控系統，鼎鳴科技股份有限公司，50 萬元，2023 年。
13. 聲波加工狀態監控系統，嵩富機械廠股份有限公司，80 萬元，2023 年。
14. 半導體材料加工製程開發研究，展暘精密工業股份有限公司，90 萬元，2023 年。
15. 旭東機械工業人才培育及產學合作計畫，旭東機械工業股份有限公司，30 萬元，2022 年。
16. 智能化加工表面精度預測系統，凱柏精密機械股份有限公司，109.5 萬元，2022 年。
17. 柔性刀損聲波智能化系統開發，優蘆國際有限公司，50 萬元，2022 年。
18. 乾燥機分離盤分析規劃，永信藥品工業股份有限公司，32 萬元，2022 年。
19. 模擬離岸風電制動器 AI 辨識產線，光隆精密工業股份有限公司，50 萬元，2022 年。
20. 均溫板高密合夾持治具，慶鴻機電工業股份有限公司，90 萬元，2022 年。
21. 自動化系統軟體開發，元順利有限公司，40 萬元，2022 年。
22. 旭東機械工業人才培育及產學合作計畫，旭東機械工業股份有限公司，40 萬元，2021 年。

23. 單晶碳化矽化學機械拋光製程技術開發，艾格生科技股份有限公司，300 萬元，2020 年。
24. 高速鑽石及 CBN 砂輪開發研究，中國砂輪公司，89.2 萬元，2020 年。
25. 平面磨床自動化對刀系統開發研究，普發工業股份有限公司，50 萬元，2020 年。
26. 模具加工技術開發研究，綠點高新科技股份有限公司，50 萬元，2020 年。
27. 航太超合金與複合材料加工之智慧超音波加工模組開發計劃，漢鼎智慧科技股份有限公司，100 萬元，2020 年。
28. 旭東機械工業人才培育及產學合作計畫，旭東機械公司，60 萬元，2019 年。
29. 高速鑽石及 CBN 砂輪開發研究，中國砂輪公司，85.2 萬元，2019 年。
30. 減震刀把模態分析與實務驗證之研究，鉦錡企業有限公司，60 萬元，2019 年。

技術移轉(近五年)

1. 化合物半導體材料研磨工具開發研究，北聯研磨科技股份有限公司，(2023 年)。
2. 化合物半導體材料加工製程開發研究，穩晟材料科技股份有限公司，(2023 年)。
3. 研磨加工製程狀態監控系統，鼎鳴科技股份有限公司，(2023 年)。
4. 鑄砂加工產線效能分析驗證，源潤豐鑄造股份有限公司，(2023 年)。
5. 聲噪智能研磨加工製程狀態監控系統，豪峰科技股份有限公司，(2023 年)。
6. 聲波加工狀態監控系統，嵩富機械廠股份有限公司，(2023 年)。
7. 半導體材料加工製程開發研究，展暘精密工業股份有限公司，(2023 年)。
8. 智能化加工表面精度預測系統，凱柏精密機械股份有限公司，(2022 年)。
9. 銑削加工刀具性能及刀具壽命研究，元駿國際有限公司，(2022 年)。
10. 柔性刀損聲波智能化系統開發，優蘆國際有限公司，(2022 年)。
11. 乾燥機分離盤分析規劃，永信藥品工業股份有限公司，(2022 年)。
12. 模擬離岸風電制動器 AI 辨識產線，光隆精密工業股份有限公司，(2022 年)。
13. 自動化系統軟體開發，元順利有限公司，(2022 年)。
14. 智能化加工表面精度預測系統，凱柏精密機械股份有限公司，(2021 年)。
15. 鑄件薄膜研磨拋光技術開發及加工應用技術人才培育，光隆精密工業股份有限公司，(2021 年)。
16. 沖壓作業自動化改善，新萊應材科技有限公司，(2021 年)。
17. 砂輪磨削狀態智慧監測系統開發研究，福裕事業股份有限公司，(2021 年)。
18. 創新蜂巢式研磨工具開發研究，中國砂輪企業股份有限公司，(2021 年)。
19. 超硬鑄鐵合金切削特性研究開發，光隆精密工業股份有限公司，(2021 年)。
20. 可調式定壓彈簧刀把專利授權，旭泰精密機械股份有限公司，(2020 年)。
21. 單晶碳化矽化學機械拋光製程技術開發，艾格生科技股份有限公司，(2020 年)。
22. 高速鑽石及 CBN 砂輪開發研究，中國砂輪公司，(2020 年)。
23. 減震刀把模態分析與實務驗證之研究，鉦錡企業有限公司，(2019 年)。
24. 高速鑽石及 CBN 砂輪開發研究，中國砂輪公司，(2019 年)。
25. 超音波輔助非金屬切割系統模組開發，聯盛機電工業股份有限公司，(2019 年)。

注意事項：

一、請詳列個人發表之著作，依期刊及會議論文、專書、作品、成就證明、技術報告、專利、發明及其他等順序分類填寫。

二、各類著作請依發表時間先後順序填寫，各項著作請依作者（按原出版之次序）、出版年、月份、題目、期刊名稱（專書出版社）及起迄頁數之順序填寫。

三、本表若不敷使用，請以 A4 紙張自行延伸；本表資料除紙本 1 份外，並請繳交 PDF 檔。

參、學術獎勵及榮譽事蹟（含服務及貢獻）

學術競賽

授 獎 單 位	內 容	日 期	文 號
台灣磨粒加工學會	ISSAT2023 「The study on the Grinding Performance of Poly SiC Hard and Brittle Material by Diamond Grinding Wheel」，Excellent Paper Award.	112 年 12 月 10 日	-
國立彰化師範大學	CSME2023 中國機械工程學會第四十屆全國學術研討會學生論文競賽，作品「化合物半導體晶砷材料之線切割搭配雙旋軸結合超音波振動輔助製造智能化技術開發」，榮獲第三名。	112 年 12 月 1 日	-
國立中興大學	2023 年第十二屆中興大學「精密工具機與智慧化技術」專題實作競賽暨程泰集團「精密工具機與智慧化技術」專題實作獎，榮獲研究生組第二名。	112 年 10 月 14 日	-
台灣三菱電機自動化股份有限公司	2022 年三菱電機 APP 開發實作設計競賽，作品「具 AI 終身學習及最佳化之智能精密研磨專家系統 APP」榮獲第三名。	111 年 9 月 7 日	-
全球傳動科技股份有限公司	2021 年第六屆全球傳動智能自動化創意實作大賽，作品「自動香菇剪柄機」，榮獲佳作獎。	110 年 11 月 26 日	勤益科大研發獎字第 110100006 號
全球傳動科技股份有限公司	2021 年第六屆全球傳動智能自動化創意實作大賽，作品「自動香菇剪柄機」，榮獲最佳人氣獎。	110 年 11 月 26 日	勤益科大研發獎字第 110100002 號
國立勤益科技大學	109 學年度機械工程系實務專題競賽暨成果展-實品類(2)-指導作品「鑽石線切割效率改善模組開發」榮獲佳作。	110 年 6 月 30 日	-
國立勤益科技大學	109 學年度機械工程系實務專題競賽暨成果展-研究類-指導作品「新式蜂巢式砂輪修整方法比較及修整後實際磨削性能之探討」榮獲佳作。	110 年 6 月 30 日	-
財團法人精密機械研究發展中心	2020 智慧機械 SMB APP 競賽活動，榮獲佳作。	109 年 11 月 20 日	-

授 獎 單 位	內 容	日 期	文 號
中國機械工程學會	2020 中國機械工程學會第 37 屆全國學術研討會學生論文競賽，作品「封閉式高轉速催化蝕刻機械研磨拋光技術開發研究-單晶碳化矽(SiC)」榮獲佳作。	109 年 11 月 20 日	-
台灣三菱電機自動化股份有限公司	2020 年三菱電機 APP 開發實作設計競賽，作品「智能化超音波輔助加工先進材料品質預測及效能改善系統加值軟體」榮獲第一名。	109 年 10 月 15 日	-
國立勤益科技大學	2019 年全國大專院校創客創業競賽，榮獲第一名。	108 年 12 月 13 日	(108)勤益科大產學獎字第 1080010478 號
旭泰精密機械股份有限公司、國立中興大學	2019 年第五屆旭泰科技論文獎評審委員	108 年 11 月 10 日	
國立勤益科技大學	108 學年度機械工程系實務專題競賽暨成果展-實品類(1)-指導作品「工具機自動化拋光系統模組應用與開發」榮獲第一名。	108 年 6 月 10 日	-
福星熱能科技股份有限公司	2019 年指導學生參加福星熱能創意競賽，作品「Research on Grinding and Polishing System Module Applied to CNC Machine」，榮獲第二名。	108 年 2 月 15 日	-
旭泰精密機械股份有限公司、國立中興大學	2018 年第四屆旭泰科技論文獎評審委員。	107 年 7 月 25 日	-
國立勤益科技大學	106 學年度機械工程系實務專題競賽暨成果展-研究類組-指導作品「五軸加工策略研究&拋光」榮獲第一名。	107 年 5 月 31 日	-
國立臺北科技大學	ICI2017 「An investigation of Vibration Assisted Deep groove EDM of Titanium alloy(Ti-6Al-4V)」，Best Paper Award.	106 年 9 月 29 日	-
國立勤益科技大學	105 學年度機械工程系實務專題競賽暨成果展-研究類組-指導作品「新式樣抗振刀銑開發之研究」榮獲第三名。	106 年 6 月 8 日	-

授 獎 單 位	內 容	日 期	文 號
國立臺北科技大學	ICSS2017 「Effects of Milling Feed Rate and Tool Diameter on Cutting Forces and Cutting Coefficient for Medium Carbon Steel(S45C)」，Best Paper Award.	106 年 4 月 6 日	-
國立臺北科技大學	ICSS2017 「Investigation of Polishing Behaviors using a Combined Diamond Impregnated Lapping Plate」，Best Paper Award.	106 年 4 月 6 日	
國立臺北科技大學	ICSS2017 「Ultrasonic-Assisted Ppolishing Mold Steel using Polyurethane Tool」，Best Paper Award.	106 年 4 月 6 日	
國立中興大學	2016 年第二屆旭泰科技論文獎，作品「創新振動機構輔助鈦合金(Ti-6Al-4V)深溝放電特性探討」，榮獲科技論文競賽類別優良創意獎。	105 年 10 月 1 日	-
	ICCPE2016 「Rotary Ultrasonic-Assisted Milling of Hardened Stainless Mold Steel」，Best Paper Award.	105 年 9 月 30 日	-
國立勤益科技大學	104 學年度機械工程系實務專題競賽暨成果展-實務成品類組(一)-指導學生作品「放電加工夾頭4.0」榮獲佳作。	105 年 6 月 2 日	-
臺灣機械工業同業公會	2016 機械工業產學貢獻獎，產學合作計畫「銑削製程的切削力與刀具顫振實驗分析」。	105 年 3 月 24 日	臺機公會業字第 105031 號
上銀科技股份有限公司與中國機械工程學會	2015 第 12 屆科技大學特別獎，作品「碳面單晶碳化矽材料移除率之拋光製程研究」榮獲特別獎。	104 年	上銀機碩獎(15)字第 026 號
國立勤益科技大學	2015 年第一屆旭泰科技論文獎，作品「Investigation of Milling Cutting Forces and Cutting Coefficient for Aluminum 6060-T6」榮獲科技論文競賽類別佳作。	104 年 11 月 28 日	-

授 獎 單 位	內 容	日 期	文 號
國立中興大學	第四屆中興大學「精密工具機與自動化技術」專題實作競賽暨程泰集團「精密工具機與自動化技術」專題實作獎，作品「多功能研磨拋光機開發研究」榮獲研究生組中科產學訓獎。	104年9月18日	-
全研科技有限公司與國立中興大學	2015 第五屆全研科技論文獎，作品「XXY 對位平台用於單晶碳化矽加工前後量測之研究」榮獲對位平台創意應用實作類銀研獎。	104年9月5日	-
經濟部智慧財產局	2014 年台北國際發明暨技術交易展，發明競賽作品「雙面修整器」榮獲金牌獎。	103年9月20日	
國立勤益科技大學	101 學年度機械工程系實務專題競賽暨成果展-實品類組(一)-指導學生作品「無動力種子播種機構」榮獲冠軍。	102年5月16日	-
台灣區機器工業同業公會	2013 機械業產學貢獻獎-產學合作計畫「單顆鑽石刮痕攝影實驗之研究」。	102年3月28日	
TIIAWA 台灣國際發明得獎協會	第四屆國際創新發明海報競賽，作品「新式 CMP 雙面組合式鑽石修整器開發研究」，榮獲 Gold Medal。	102年	-
上銀科技股份有限公司與中國機械工程學會	2011 第 8 屆科技大學特別獎，作品「超音波輔助鑽石修整器與高壓噴射修整 CMP 拋光墊技術開發研究」榮獲特別獎。	100年	上銀機碩獎(11)字第 033 號

服務及貢獻

授 獎 單 位	內 容	日 期	文 號
臺中市軸承商業同業公會	擔任第二屆技術顧問	112年5月25日	-
低碳產業永續發展聯盟	擔任第一屆顧問	112年3月29日	-
社團法人中華工程教育學會	2024 年度「工程及科技教育認證」之認證團成員。	112年8月	中工教字第 1120000430 號
經濟部	經濟部科技研究發展專案-產業升級創新平台輔導計畫審查會員	111年~113年	-
國立勤益科技大學	產學合作傑出，榮獲講座教授	110年~111年	勤益科大入字第 1101700296-B 號

授 獎 單 位	內 容	日 期	文 號
國立勤益科技大學	產學合作傑出，榮獲特聘教授	106年~110年、112年	-
中國工程師學會	第73屆會員代表大會代表。	111年7月1日	中工秘字第111072342號
台灣精密工程學會	111年精密工程專題與論文獎競賽評審委員。	111年2月	-
國立勤益科技大學	109年技轉績優教師第二名。	110年12月31日	-
台灣電子設備協會	設備國產化推動產學研專家會議-長晶、磊晶先進製程技術未來發展趨勢及國產設備投入機會之與談人	110年8月27日	-
彰化縣政府	110年~111年地方產業創新研發推動計畫技術審查委員	110年5月	-
中國機械工程學會	第57屆候補理事(110年1月~111年12月)	110年2月18日	(57)中機發字第110006號
國立勤益科技大學	辦理108學年度科技大學校務評鑑作業。	109年11月	(109)人證字第009號
財團法人台灣產業服務基金會	經濟部工業局綠色工廠標章制度之清潔生產技術審查小組委員	109年5月7日	財台產基字第1090001204號
社團法人中華工程教育學會	2021年度「工程及科技教育認證」之認證團成員。	109年8月5日	中工教字第1090000313號
國立中興大學	109年工程及科技教育認證，諮詢委員會委員	109年11月20日	-
行政院國家科學委員會工程處	109年度機械固力學門小產學成果發表共同主持人	109年12月	-
台灣精密工程學會	擔任2018年第一屆川寶科技論文獎大會組織成員。	107年11月29日	-
國立勤益科技大學	辦理105學年度專業類自我評鑑工作。	106年8月21日	(106)人證字第57號
國立勤益科技大學	105年度推動研究發展績效卓越(學術期刊論文獎)	106年8月1日	勤益科大研字第1061300370號
彰化縣政府	106年度地方產業創新研發推動計畫技術審查委員	106年6月	府建產字第1060194386號
國立勤益科技大學	105年度工程學院績效優良教師/技術移轉類/第三名。	106年3月14日	-
國立勤益科技大學	105年度工程學院績效優良教師/學術論文類/第三名。	106年3月14日	-
國立勤益科技大學	協助本校IWMST2016國際研討會外賓接待。	105年12月	(105)人證字第15號

授 獎 單 位	內 容	日 期	文 號
國立勤益科技大學	104 年度推動研究發展績效卓著 (學術期刊論文獎)	105 年 8 月 1 日	勤益科大研字第 1051300400 號
國立勤益科技大學	104 年度推動研究發展績效卓著 (專利獎)	105 年 8 月 1 日	勤益科大研字第 1051300400 號
國立勤益科技大學	104 年度推動研究發展績效卓著 (競賽獎)	105 年 8 月 1 日	勤益科大研字第 1051300400 號
國立中興大學	105 年工程及科技教育認證，諮 詢委員會委員	105 年 12 月 16 日	-
國立中興大學	104 年工程及科技教育認證，諮 詢委員會委員	104 年 12 月 8 日	-
國立勤益科技大學	辦理 103 學年度科技大學綜合評 鑑業務。	104 年 10 月	(104)人證字第 67 號
國立勤益科技大學	103 年度推動研究發展績效卓著 (學術期刊論文獎)	104 年 8 月 4 日	勤益科大研字第 1041300418 號
國立勤益科技大學	103 年度推動研究發展績效卓著 (國際發明展獎)	104 年 8 月 4 日	勤益科大研字第 1041300418 號
國立勤益科技大學	執行本校 103 年度發展典範科技 大學計畫。	104 年 6 月 25 日	(103)典大獎字第 089 號
國立勤益科技大學	103 年度工程學院績效優良教師/ 一般研究計畫類/第三名。	104 年 3 月 17 日	-
國立勤益科技大學	103 年度工程學院績效優良教師/ 技術移轉類/第二名。	104 年 3 月 17 日	-
國立中興大學	103 年工程及科技教育認證，諮 詢委員會委員	103 年 12 月 3 日	-
國立勤益科技大學	執行典範科技大學計畫各分項活 動。	103 年 11 月	(103)人證字第 51 號
國立勤益科技大學	102 年度推動研究發展績效卓著 (競賽獎)。	103 年 9 月	103 年 8 月 20 日勤 益科大研字第 1031300413 號
國立勤益科技大學	102 年度推動研究發展績效卓著 (專利獎)。	103 年 9 月	103 年 8 月 20 日勤 益科大研字第 1031300413 號
國立勤益科技大學	102 年度工程學院績效優良教師/ 技術移轉類/第三名。	103 年 6 月 11 日	-
行政院國家科學委 員會工程處	102 年度機械固力學門專題研究 計畫成果發表會主持人	102 年 12 月 7 日	-
國立勤益科技大學	督導單位辦理改名改制科大後第 2 次訪視作業	102 年 8 月 1 日	(102)人證字第 46 號
國立勤益科技大學	負責本校創辦人浮雕案之規劃、 審議等前置作業。	101 年 2 月 1 日	(101)人證字第 33 號

授 獎 單 位	內 容	日 期	文 號
國立勤益科技大學	100 年度推動研究發展績效卓越(專利獎)。	101 年 9 月	101 年 7 月 31 日勤益科大研字第 1011300353 號
國立勤益科技大學	協助工程學院獲教育部核准通過設立 101 學年度精密製造研究所博 班。	100 年 8 月 18 日	(100)人證字第 25 號

注意事項：

一、相關文件請附影本。

二、如為外國文件，請附中譯本並公證。

三、本表若不敷使用，請以 A4 紙張自行延伸；本表資料除紙本 1 份外，並請繳交 PDF 檔。

肆、個人自述：（包括經驗、治校理念、抱負及妥善運用資源之規劃）

後學蔡明義，於82年進入本校機械工程系任教職迄今已超過30年，從**最基層的助教、講師、副教授、教授、特聘教授、至講座教授**一路深受勤益師長前輩的栽培及照顧。後學對學校有濃厚感情，熟悉學校教職員工及週邊環境，了解學校優弱勢及面臨的挑戰，希望有機會與大家一起成長及改變。

後學教學行政歷練豐富，100年受到機械系教師肯定擔任系主任，因行政職務及對人才培育的熱忱，期間推動多項實務型人才培育策略：產學專班、產學訓專班、證照輔導班、大四校外實習及產業學院等，並榮獲2次台灣區機器工業同業公會機械業產學貢獻獎，除此之外協助推動成立勤益第一個博士班。民國108年受到院內教師肯定擔任工程學院院長，整合院內教師提供中小企業更完整關懷服務（執行計畫至今已輔導超過100間次廠商）。108年成立難削材加工技術產學聯盟（執行計畫至今已服務150間次廠商）與產業界互動良好。**108年擔任主持人並執行USR大學社會責任計畫，於112年通過教育部深耕型計畫-中部菇類產業創生與永續經營提升計畫(本校首件)**。除此之外，111年申請通過成立-智慧自動化工程系。

在研究的道路上後學與大家一樣，兢兢業業，揮汗向前，於106年度開始榮獲6次特聘教授，110-111年度以產學合作計畫績優榮獲講座教授、113年度再次提出申請。除此之外，連續10年獲得國科會補助大專校院獎勵特殊優秀人才獎，**並於112年通過4年期國科會-次世代智慧製造關鍵技術研發專案計畫，在全國僅核定之7案中為本校唯一通過者並且帶領學生通過113年度國科會-科創計畫(工程學院首件)**。

後學持續一貫的教學/研發理念-**從實作/動手中創新，創新中開發技術/產品及實務人才培育模式**，積極產業接軌，發揮科技大學應有本質。並且秉持創辦人「教育無他、榜樣而已」校訓，認真負責，勤於溝通協調，尊重他人意見與同仁並肩工作，決策力求透明化，對內整合資源且有效運用資源，對外積極拓展財源，精進教學研究，積極努力邁向實務型應用科技大學的願景。

未來學校願景規劃，以具**特色之實務型應用科技大學**為主：

1. **促進校園融合，建構幸福校園**：全力爭取校外經費，加強教職員工生福利，積極辦理校園活動，活絡校園並增加學生休憩空間。
2. **勤益求精，技生上流**：積極推動跨領域「專題製作」，培養學生實務整合技術及團隊溝通能力。
3. **跨領域院系均衡發展**，尊重支持院系所發展其特色，並提供互相支援發展跨領域創新教學研究之機會。
4. **建構研發基地**，鎖定重點領域發展，共同推動智慧製造，半導體與綠色環境。整合研究資源，重點發展已有的優勢領域，組成跨系所與跨院的研究團隊，向政府相關機構及產業爭取大型研究計劃經費。
5. **改善研究環境**，整合貴重儀器設備/實驗室，編列預算，推動成立學校貴儀中心，共同添購與維護儀器，落實資源集中與共享。
6. **建構雙語學園**，協助學生強化國際移動能力並且獎勵高階外籍生就讀，增加研發生力軍。
7. **重視本校本質能力及特色**，鏈結國際標杆學校加值學校發展，建立本校與姊妹校教師學生互訪或相互講學/交流之機制。
8. **永續校園與地方創生發展**：擴大USR大學社會責任計畫推動，積極與地方產業對接合作，協助提高產業價值。
9. **加強校友聯繫，凝聚校友向心力**：積極鼓勵校友返校演講、座談，參與學生專題製作並聆聽校友建言，促進校友與學校之間的人才培育及研發合作。

10. 強化校務經營體質，建立充分溝通管道，明確各級主管權限與責任，分層負責有效達成任務；規劃不同單位橫向聯繫機制，協調一致共同解決問題，建立各項校務制度與績效考評機制，追蹤考核提高效能品質。
11. 強化學生事務服務，活潑學生社團，鼓勵學生參與社團活動，促進學生全方位及多元化發展。

後學將勇於改變、熱情工作、誠信待人，建構以學生為本的友善校園且協助產業升級之具特色之實務型應用科技大學。

注意事項：

- 一、請以中文撰寫，以一千五百字為限，並請以電腦繕打。
- 二、本表若不敷使用，請以 A4 紙張自行延伸，本表資料除紙本 1 份外，並請繳交 PDF 檔。

伍、徵求方式

一、推薦產生（請擇一勾選）

- 本校編制內、外專任教授、副教授及助理教授十人以上連署推薦。
- 校外教授、副教授或研究員、副研究員十五人以上之連署推薦。
- 本校校友二十人以上連署各得推薦一人。

二、 自行參選。

三、 本校校長遴選委員會舉薦。

陸、相關承諾

- 1、 本人已充分瞭解國立勤益科技大學第九任校長遴選相關規定，同意並接受擔任校長候選人。
- 2、 本人聲明未具教育人員任用條例第 31 條所定情事。
- 3、 本人聲明未有曾經教育部、國家科學及技術委員會（含原科技部）或服務機關學校判定違反學術倫理之情事。
- 4、 本人承諾若獲聘為國立勤益科技大學校長，於擔任校長期間，處事公正並能超出政治、宗教、黨派及利益團體；如已兼任上述機關團體職務，將於應聘校長前辭去兼職，就任校長期間亦不兼任。
- 5、 本人聲明所填送之資料及學經歷資格證明文件均確實無誤；若有不實，本人願負一切責任。

候選人簽名：



中 華 民 國 1 1 3 年 6 月 1 1 日